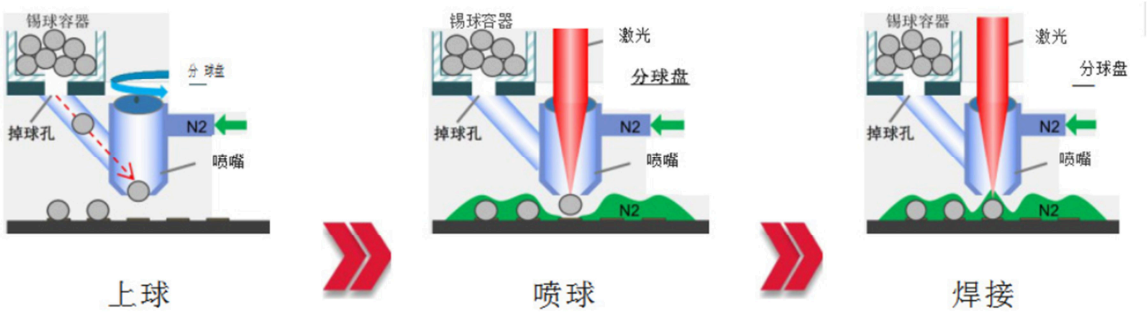
激光焊接锡球喷嘴规格书

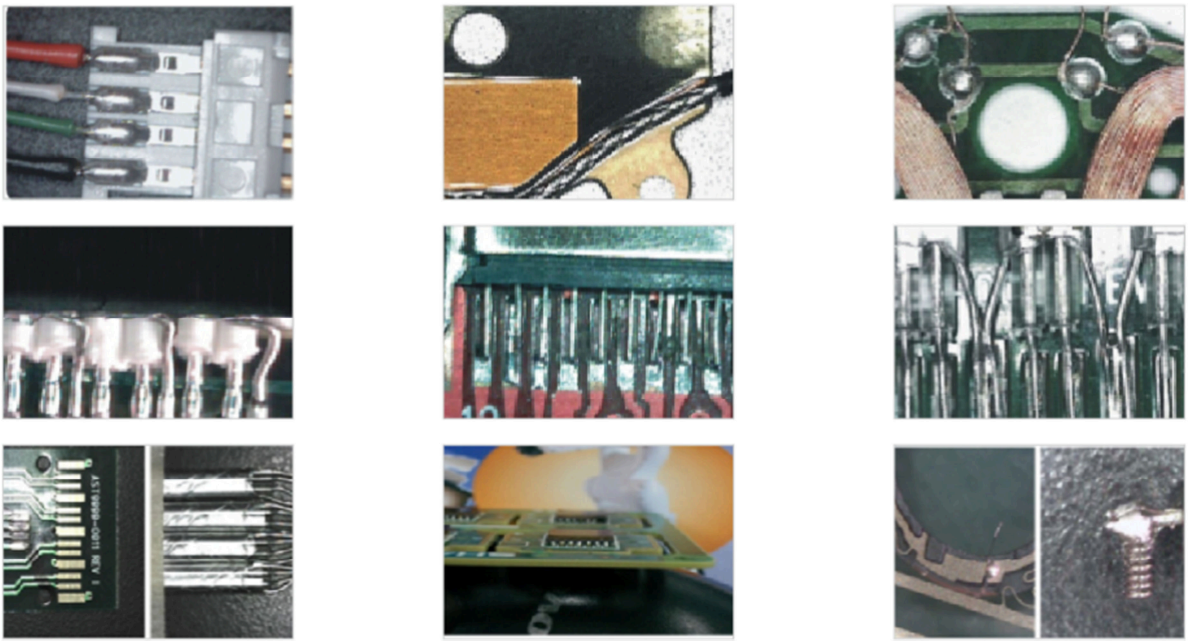
简 介

激光锡球焊接机是将容器中的锡球通过特制的单锡珠分球系统转移至喷射头，通过激光的高脉冲能量，瞬间熔化置于喷射头上的锡球，再利用惰性气体压力将熔化后的锡料，喷射到焊点表面，形成互联焊点。这种工艺的主要优点是能实现极小尺寸的互连，熔滴大小可小至几十微米。激光锡球焊接机采用光纤激光器，与工控系统高度集成于工作台机柜，搭配植球机构实现锡球与激光焊接同步，配双龙门系统，上料、下料、自动定位、焊接同步进行，实现高效自动焊接，能够满足精密级元器件比如摄像头模组、VCM 漆包线圈模组和触点盆架、磁头等精密微小元器件、晶圆，光电子产品，MEMS，传感器，BGA,HDD(HGA, HAS)，手机通讯、数码相机、摄像头模组等高精密部件的焊接焊接，具有一定范围的特殊应用性。



一般来说，当激光锡球焊接机的焊接精度在 0.1mm 以上，或者焊接速度要求大于 1 个锡球每秒时，就需要用到高精密喷嘴，作为锡球出口的喷嘴应用于激光锡球焊接机上，要求喷嘴具有高精密性，喷嘴内壁光滑，无断差和无毛刺，需要保证使用时不出现飞球、堵球的现象，具有极好的一致性及连续性，高精密钨钢喷嘴精度可达 30-50 微米的重复焊接精度。

锡球焊接的各种应用：



特 征

1.体积小，精度高，适应连续使用的要求

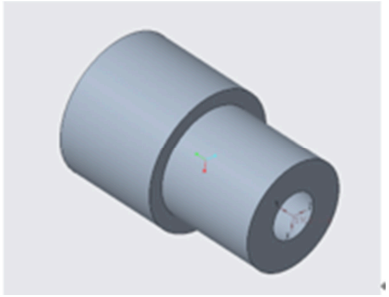
2. 可靠性高及寿命长

3. 据激光设备机械使用图纸要求，接受精密定制加工微孔。

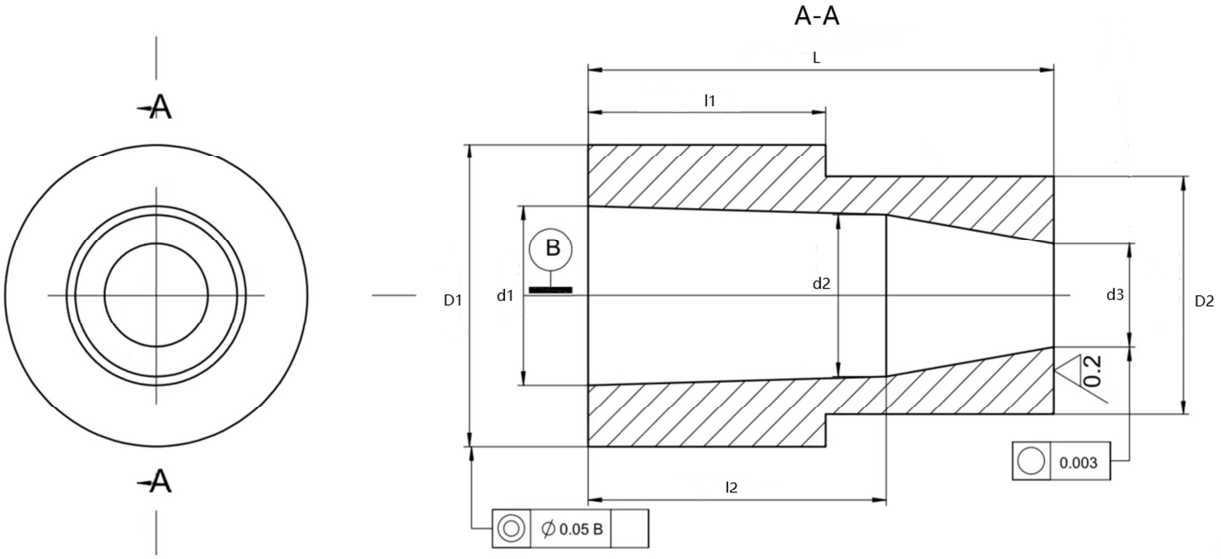
应 用

1.激光锡球焊接机

锡球喷嘴示意图



锡球喷嘴截面图示



技术参数

喷嘴 型号	外直径 D1(mm)	内直径 d1(um)	喷嘴内直径 d3(mm)	总长度 L(mm)	内壁光洁度 (um)	备注
VC28098	2.8	1.66	0.98	4.31	Ra0.4	本司接受来图定制、来样定制
VC28114	2.8	1.66	1.14	3.8	Ra0.4	
VC28096	2.8	1.66	0.96	4.31	Ra0.4	

我司接受来图定制，并免费出样品给客户试样。